

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2023-002

## **龙迅半导体（合肥）股份有限公司**

### **关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成工商变更登记，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将本次工商变更登记相关情况公告如下：

#### **一、公司注册资本和股份数量等变更的相关情况**

公司根据中国证券监督管理委员会于2023年1月4日出具的《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,314,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币64.76元，募集资金总额为人民币112,130.10万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币103,028.10万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了“容诚验字〔2023〕230Z0030号”《验资报告》。

本次发行完成后，公司注册资本由51,944,146.00元变更为69,258,862.00元，股份总数由51,944,146股变更为69,258,862股，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，据此，公司将《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行修订。上述相关事宜已经公司董事会、股东大会授权办理。

#### **二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况**

修订的《公司章程》具体内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【注册日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【上市日期】在【上海证券交易所科创板】上市。	第三条 公司于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股17,314,716股，于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,925.8862万元。
第十八条 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管】集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股，每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为6,925.8862万股，均为人民币普通股，每股面值1元。

除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

换发的《营业执照》具体信息如下：

名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司

统一社会信用代码：913400007950924118

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：陈峰

注册资本：陆仟玖佰贰拾伍万捌仟捌佰陆拾贰人民币元整

成立日期：2006年11月29日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋

经营范围：集成电路、电子产品的研发设计、生产、销售及相关的技术咨询服务；计算机软硬件开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外）。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年3月4日